

无铅锡膏

◆ 产品描述

环保无铅锡膏，符合 RoHS 标准，焊接强度高、焊点光亮饱满，流动性与润湿性佳，适配精密电子制造。

◆ 产品优势

- 环保无铅
- 符合 RoHS
- 焊接强度高
- 焊点光亮
- 润湿性好

◆ 产品结构

以 Sn-Ag-Cu 合金为基材，添加环保助焊剂，经混合

研磨制成均匀膏体，密封真空包装，无重金属污染

◆ 应用场景

精密电子元器件焊接、智能手机 / 电脑制造、汽车电子生产、环保电子设备组装、医疗电子加工



◆ 产品特性

合金成分：Sn96.5-Ag3.0-Cu0.5

熔点：217-221°C

粘度：10000-15000 CPS

焊接温度：240-270°C

保质期：3 个月（冷藏）

物料编码	重量	包装方式
1.5.19.03.0004	0.6kg	独立包装

◆ 备注

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有